08.7, 2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 9月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-341451

[ST. 10/C]:

[JP2003-341451]

REC'D 02 SEP 2004

WIPO

POT

出 願 人
Applicant(s):

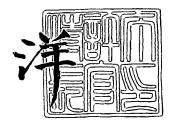
ニッタ株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OF TRANSMITTED IN

COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 8月20日

1) 1



特許願 【書類名】 30930026 【整理番号】

平成15年 9月30日 【提出日】 特許庁長官 殿 【あて先】 G01L 1/18 【国際特許分類】

【発明者】

奈良県大和郡山市池沢町172番地 ニッタ株式会社奈良工場内 【住所又は居所】

森本 英夫 【氏名】

【特許出願人】

【識別番号】 000111085

ニッタ株式会社 【氏名又は名称】

【代理人】

100089196 【識別番号】

【弁理士】

梶 良之 【氏名又は名称】

【選任した代理人】

100104226 【識別番号】

【弁理士】

須原 誠 【氏名又は名称】

【手数料の表示】

014731 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

【提出物件の目録】

特許請求の範囲 1 【物件名】

明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【物件名】 9407223 【包括委任状番号】

0000300 【包括委任状番号】



#### 【請求項1】

外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数 を計測する多軸センサユニットにおいて、

一平面上に配置された8個の歪みゲージと、各歪みゲージを連結して成る1個のブリッジ回路とを備えていることを特徴とする多軸センサユニット。

## 【請求項2】

外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数 を計測する多軸センサユニットにおいて、

一平面上に配置された8個の歪みゲージと、各歪みゲージを連結して成る2個のブリッジ回路とを備えていることを特徴とする多軸センサユニット。

## 【請求項3】

中央に設けられた受力部と外周に設けられた固定部とこれらを連結する円環形状のダイヤフラム部とを備えた起歪体を有すると共に、

前記歪みゲージの配置位置は、前記ダイヤフラムの中心線に直交する線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部との4箇所、および前記線に直交する線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部との4箇所であることを特徴とする請求項1または2に記載の多軸センサユニット。

## 【請求項4】

前記歪みゲージはピエゾ抵抗素子又はスパッタリングにより形成したひずみゲージである ことを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の多軸センサユニット。

#### 【請求項5】

請求項1~4のいずれかに記載の前記多軸センサユニットを複数備えていることを特徴とする多軸センサ。

#### 【請求項6】

前記多軸センサユニットは前記多軸センサの中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心 点から等距離に配置されていることを特徴とする請求項5に記載の多軸センサ。

### 【請求項7】

前記角度は90度であることを特徴とする請求項6に記載の多軸センサ。

#### 【請求項8】

前記多軸センサユニットは、前記中心点を原点とするX軸およびY軸上の正方向および 負方向にそれぞれ配置されていることを特徴とする請求項7に記載の多軸センサ。

#### 【請求項9】

前記角度は120度であることを特徴とする請求項6に記載の多軸センサ。

#### 【請求項10】

前記歪みゲージの配置位置は、前記多軸センサの中心点と前記多軸センサユニットの中心点とを結ぶ線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部、および前記多軸センサユニットの中心点における前記線の直交線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部であることを特徴とする請求項5~9のいずれかに記載の多軸センサ。

# 【請求項11】

前記歪みゲージを備える前記多軸センサユニットを有する第1部材と、前記多軸センサユニットに対向して前記歪みゲージを備えない前記起歪体を有する第2部材とを有すると 共に

対向する起歪体の前記受力部同士を連結して、前記第1部材と前記第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを計測することを特徴とする請求項5~10のいずれかに記載の多軸センサ。

### 【請求項12】

前記多軸センサユニットと、前記多軸センサユニットの前記受力部に設けられた作用体とを備えると共に、該多軸センサユニットに作用する多軸の加速度および角加速度を計測することを特徴とする請求項5~10に記載の多軸センサ。

#### 【書類名】明細書

【発明の名称】多軸センサユニットおよびこれを利用した多軸センサ

## 【技術分野】

## [0001]

本発明は、第1部材と第2部材とに外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、 角速度のいずれかを計測することができる多軸センサユニットおよびこれを利用した多軸 センサに関する。

## 【背景技術】

# [0002]

この種の多軸センサとして、半導体の単結晶基板を利用して力やモーメントを検出する装置が知られている。特許文献1には、図21~図23に示すように、中央に設けられた受力部100と周囲に設けられた固定部101とこれらを連結する円環形状のダイヤフラム部102とを備えた起歪体103と、この起歪体103に取り付けられたピエゾ素子などからなる検出素子R11~R34とを備えた多軸センサ105が開示されている。

## [0003]

検出素子R11~R34は各起歪体103の上面に設けられている。各起歪体103の上面では、受力部100を中心に互いに直交するX軸およびY軸と、これらの中間の斜め軸Sとが設定されている。検出素子R11~R34は各軸上のダイヤフラム部102の縁部分に配置されている。

#### [0004]

この多軸センサ105では、X, Y, Z軸の3軸方向の力やモーメントを測定するために、各検出素子R11~R34によりブリッジ回路を構成している。具体的には、X軸上の検出素子R11~R14により図23(A)に示すブリッジ回路106を構成して、これにより電圧Vxを得る。また、Y軸上の検出素子R21~R24により図23(B)に示すブリッジ回路107を構成して、これにより電圧Vyを得る。さらに、S軸上の検出素子R31~R34により図23(C)に示すブリッジ回路108を構成して、これにより電圧Vzを得る。そして、これら3つのブリッジ回路106~108により得られた電圧Vx, Vy, Vzの組み合わせによりX, Y, Z軸の3軸方向の力やモーメントを算出することができる。

#### [0005]

【特許文献1】特開平4-194634号公報(第2図、第3図、第7図、第3頁左下欄第3行~右下欄第6行、第4頁右下欄第9行~第15行)

#### 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

#### [0006]

特許文献1に記載の技術では、3個のブリッジ回路 $106\sim108$ を使用しているので消費電力が大きくなってしまう。また、3個のブリッジ回路 $106\sim108$ を構成するために配線が複雑になってしまう。特に検出素子 $R11\sim R14$ をシリコン半導体基板に形成する場合は検出素子 $R11\sim R14$ となるピエゾ抵抗素子の端子信号を半導体基板の外部に一旦引き出して配線するなどの処理が必要になるので、ブリッジ回路 $106\sim108$ が3個もあると構成が複雑になってしまう。よってコストが高くなってしまう。

#### [0007]

そこで、本発明の目的は、消費電力を低減すると共に配線を簡素にしコストを低減できる多軸センサユニットおよびこれを利用した多軸センサを提供することである。

# 【課題を解決するための手段】

#### [0008]

本発明の多軸センサユニットは、外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数を計測する多軸センサユニットにおいて、一平面上に配置された8個の歪みゲージと、各歪みゲージを連結して成る1個のブリッジ回路とを備えている。

# [0009]

この構成によると、歪みゲージは僅か8個であると共にただ1つのブリッジ回路を構成しているので、従来のように12個の歪みゲージを4個ずつ分けて3つのブリッジ回路を駆動する場合に比べて消費電力を約1/6に低減することができる。すなわち、ブリッジ回路1個あたりの歪みゲージの数が2倍に増えたので合成抵抗は2倍になり、ブリッジ回路が3個から1個になったので電力は1/3になる。ここで電力 $W=V^2/R$ であるので、(1/3)  $\times$  (1/2) により1/6になる。

## [0010]

また、ブリッジ回路が1つだけなので配線を簡素化することができる。このため、配線を立体的に交差させることなくブリッジ回路を容易に構成できるようになる。さらに、歪みゲージの数量を減らすことができるので、部品点数の減少と貼り付け作業の工数の削減によりコストを下げることができる。

## [0011]

本発明の多軸センサユニットは、外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数を計測する多軸センサユニットにおいて、一平面上に配置された8個の歪みゲージと、各歪みゲージを連結して成る2個のブリッジ回路とを備えている。

## [0012]

この構成によると、歪みゲージは僅か8個であると共に2つのブリッジ回路を構成しているので、従来のように12個の歪みゲージを4個ずつ分けて3つのブリッジ回路を駆動する場合に比べて消費電力を約2/3に低減することができる。

#### [0013]

また、ブリッジ回路が2つだけなので配線を簡素化することができる。このため、配線を立体的に交差させることなくブリッジ回路を容易に構成できるようになる。さらに、歪みゲージの数量を減らすことができるので、部品点数の減少と貼り付け作業の工数の削減によりコストを下げることができる。

## [0014]

本発明において、中央に設けられた受力部と外周に設けられた固定部とこれらを連結する円環形状のダイヤフラム部とを備えた起歪体を有すると共に、前記歪みゲージの配置位置は、前記ダイヤフラムの中心線に直交する線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部との4箇所、および前記線に直交する線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部との4箇所であることが好ましい。この構成によると、2つの直交する軸方向への力およびモーメント、さらにはこれらの軸に直交する軸方向への力を検出することができる。

#### [0015]

本発明において、前記歪みゲージはピエゾ抵抗素子であることが好ましい。この構成によると、ピエゾ抵抗素子は箔歪みゲージに比べてゲージ率が10倍以上大きいので、箔歪みゲージを利用する場合に比べて感度を10倍以上大きくすることができる。同様に本発明において、前記歪みゲージはスパッタリング法で形成したひずみゲージであることが好ましい。この製造方法によるひずみゲージは、一般的な箔歪みゲージに比べてゲージ率が10倍以上大きいので、一般的な箔歪みゲージを利用する場合に比べて感度を10倍以上大きくすることができる。

## [0016]

本発明において、上述のいずれかに記載の前記多軸センサユニットを複数備えていることが好ましい。この構成によると、3軸の力およびモーメント、あるいは加速度および角加速度を高精度に検出できるようになる。

### [0017]

本発明において、前記多軸センサユニットは前記多軸センサの中心点を中心に等角度おき、かつ前記中心点から等距離に配置されていることが好ましい。この構成によると、各多軸センサユニットの歪みゲージの抵抗値の変化から比較的簡易な計算により多軸の力、モーメント、加速度、角加速度を算出することができる。

# [0018]

本発明において、前記角度は90度であることが好ましい。この構成によると、多軸センサの中心点を原点とする直交座標のX軸およびY軸での力、モーメント、加速度、角加速度を容易に算出することができる。

# [0019]

本発明において、前記多軸センサユニットは、前記中心点を原点とするX軸およびY軸上の正方向および負方向にそれぞれ配置されていることが好ましい。この構成によると、X軸およびY軸での力、モーメント、加速度、角加速度を極めて容易に算出することができる。

# [0020]

本発明において、前記角度は120度であることが好ましい。この構成によると、3個の多軸センサユニットで多軸の力、モーメント、加速度、角加速度を算出することができるので、多軸センサの構成を更に簡易化することができる。

#### [0021]

本発明において、前記歪みゲージの配置位置は、前記多軸センサの中心点と前記多軸センサユニットの中心点とを結ぶ線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部、および前記多軸センサユニットの中心点における前記線の直交線上において前記ダイヤフラムの外縁部と内縁部であることが好ましい。

#### [0022]

この構成によると、多軸センサユニットの中で最も歪みが大きい部位に歪みゲージを取り付けることができるので、感度を高めることができる。

## [0023]

本発明において、前記歪みゲージを備える前記多軸センサユニットを有する第1部材と、前記多軸センサユニットに対向して前記歪みゲージを備えない前記起歪体を有する第2部材とを有すると共に、対向する起歪体の前記受力部同士を連結して、前記第1部材と前記第2部材との間に作用する多軸の力およびモーメントを計測することが好ましい。

#### [0024]

この構成によると、片方の部材のみに多軸センサユニットを設けるだけで多軸の力およびモーメントを計測することができる。

#### [0025]

本発明において、前記多軸センサユニットと、前記多軸センサユニットの中央部に設けられた作用体とを備えると共に、該多軸センサユニットに作用する多軸の加速度および角加速度を計測することが好ましい。この構成によると、片方の部材のみに多軸センサユニットを設けるだけで多軸の加速度および角加速度を計測することができる。

#### 【発明の効果】

#### [0026]

以上説明したように、本発明によると、歪みゲージは僅か8個であると共にただ1つのブリッジ回路を構成している場合には、従来のように12個の歪みゲージを4個ずつ分けて3つのブリッジ回路を駆動する場合に比べて消費電力を約1/6に低減することができる。また、歪みゲージは僅か8個であると共に2つのブリッジ回路を構成している場合には、従来のように12個の歪みゲージを4個ずつ分けて3つのブリッジ回路を駆動する場合に比べて消費電力を約2/3に低減することができる。よって、省電力化を図ることができる。

## [0027]

また、ブリッジ回路が1つまたは2つだけなので配線を簡素化することができる。このため、配線を立体的に交差させることなくブリッジ回路を構成できるようになる。よって、ICプロセスやスパッタリング技術でブリッジを構成する場合に、配線を交差させる必要が無くなるので、工程が簡略化されてコストの低減を図ることができる。さらに、歪みゲージの数量を減らすことができるので、部品点数の減少と貼り付け作業の工数の削減によりコストを下げることができる。

# [0028]

そして、2つの直交する軸方向への力およびモーメント、さらにはこれらの軸に直交する軸方向への力を検出することができる。また、ピエゾ抵抗素子あるいは、スパッタリングにより形成したひずみゲージの利用により、ピエゾ抵抗素子あるいは、スパッタリングにより形成したひずみゲージは、一般的な箔歪みゲージに比べてゲージ率が10倍以上大きいので、箔歪みゲージを利用する場合に比べて感度を10倍以上大きくすることができる。

# [0029]

さらに、3軸の力およびモーメント、あるいは加速度および角加速度を高精度に検出できるようになる。また、各多軸センサユニットの歪みゲージの抵抗値の変化から比較的簡易な計算により多軸の力、モーメント、加速度、角加速度を算出することができる。多軸センサの中心点を原点とする直交座標のX軸およびY軸での力、モーメント、加速度、角加速度を容易に算出することができる。X軸およびY軸での力、モーメント、加速度、角加速度を極めて容易に算出することができるようにもなる。3個の多軸センサユニットで多軸の力、モーメント、加速度、角加速度を算出することができるので、多軸センサの構成を更に簡易化することができる。

# [0030]

また、多軸センサユニットの中で最も歪みが大きい部位に歪みゲージを取り付けることができるので、感度を高めることができる。そして、片方の部材のみに多軸センサユニットを設けるだけで多軸の力およびモーメント、あるいは加速度および角加速度を計測することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

# [0031]

以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。

#### [0032]

図1 (A) は、本発明の第1の実施の形態による多軸センサユニット10を歪みゲージの取り付け面側から見たときの平面図であり、図1 (B) は多軸センサユニット10の中央縦断面正面図である。図1において、多軸センサユニット10は、外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれか1つまたは複数を計測するものである。この多軸センサユニット10は、一平面上に配置された8個の歪みゲージR11 $\sim$ R24 を連結して成る1個のブリッジ回路11とを備えている。

# [0033]

各歪みゲージR11~R24は、アルミやSUSなどの金属製可撓性材料から成る起歪体12に取り付けられている。起歪体12は、中央に設けられた受力部13と、外周に設けられた固定部14と、これらを連結する円環形状のダイヤフラム部15とを備えている。固定部14は多軸センサユニット10を他の装置に取り付けるためのものであり、受力部13に外力が与えられても歪みや変形が発生しにくいように肉厚の大きい剛性の高いものとしている。ダイヤフラム部15は変形し易い薄肉状としている。受力部13は棒状とされ、外部から受けた力を効率良くダイヤフラム部15に伝達する。よって、受力部13に外力を与えると、歪みや変形は殆どダイヤフラム部15に集中する。

#### [0034]

歪みゲージR11~R24としては、金属箔歪みゲージや金属線歪みゲージを用いている。歪みゲージR11~R24は一種の抵抗体であり、歪みの発生する場所に貼り付けて使用する検出素子である。歪みの発生により抵抗値が変化することにより、歪み $\epsilon$ を測定することができる。一般には、引張りによる歪み $\epsilon$ に対しては抵抗値が大きくなり、圧縮による歪み $\epsilon$ に対しては抵抗値が小さくなる比例特性を持っている。また、通常は材料が歪み $\epsilon$ に対して応力 $\epsilon$ が比例する弾性域で使用する。

#### [0035]

歪みゲージR11~R24の配置位置は、ダイヤフラム部15の中心線(Z軸)に直交 出証特2004-3074976 する線 (X軸) 上においてダイヤフラム部15の外縁部と内縁部との4箇所、およびX軸 に直交する線(Y軸)上においてダイヤフラム部15の外縁部と内縁部との4箇所として いる。歪みゲージR11~R24は各位置に貼り付けられている。いずれの歪みゲージR 11~R24もダイヤフラム部15の縁部に設けられているので、起歪体12に発生した 歪みを効率良く受けることができる。

# [0036]

図2に、多軸センサユニット10の受力部13にX軸方向の力Fxを加えたときの状態 および各歪みゲージR11~R14の変化を示す。力Fxは、受力部13の作用点13a と多軸センサユニット10の原点Oとの距離Lに対応したモーメントMy(Y軸回りのモ ーメント)として作用する。このときは、X軸上の全ての歪みゲージR11~R14が図 示したように変位し、歪みが検出される。図中、歪みゲージR11~R24の(+)は引 っ張り方向の歪みを受けて抵抗値が増加したこと、(一)は圧縮方向の歪みを受けて抵抗 値が減少したことを示す。

### [0037]

次に、多軸センサユニット10の受力部13にY軸方向の力Fyを加えたときは、力F yは受力部13の作用点13aと多軸センサユニット10の原点Oとの距離Lに対応した モーメントMx(X軸回りのモーメント)として作用する。これは上述したX軸方向の力 Fxを加えたときの状態を90度ずらして考えればよいので、ここでは省略する。

#### [0038]

図3に、多軸センサユニット10の受力部13に Z軸方向の力Fzを加えたときの状態 および各歪みゲージR11~R24の変化を示す。

## [0039]

表1に上述した各力およびモーメントに対する歪みゲージR11~R24の変化を示す 。表中、+は抵抗値の増加、-は抵抗値の減少を示し、0は抵抗値が殆ど変化しないこと を示す。また、反対方向の力やモーメントの場合は符号が逆になる。

## [0040]

## 【表1】

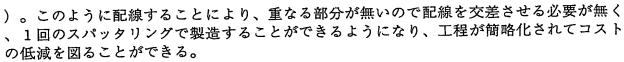
ひずみゲージ	×軸				Y 軸			
	R11	R12	R13	R14	R21	R22	R23	R24
Fx(My)	-	+	-	+	0	0	0	0
Fy(Mx)	0	0	0	0	_	+	_	+
Fz	-	+	+	_		+	+	_

## [0041]

図4に、各歪みゲージR11~R24を接続してなるブリッジ回路11を示す。このブ リッジ回路11では、駆動用電圧V+からGNDまでをR11→R12→R23→R24 で直列させると共に、R14→R13→R22→R21で直列させる。なお、R12とR 14とは入れ替えてもよい。そして、R11とR12の節点aの電圧をVa、R13とR 14の節点bの電圧をVb、R23とR24の節点cの電圧をVc、R21とR22の節 点dの電圧をVdとする。なお、R12とR23の節点gとR13とR22の節点hとを 短絡させてもよい。

### [0042]

図1 (A) に、各歪みゲージR11~R24を接続する配線図を示す(図中、二点鎖線 出証特2004-3074976



## [0043]

#### [0044]

#### [0045]

また、力Fzが与えられたときは、図7(A)に示すように力Fzの方向によって作動する歪みゲージ $R11\sim R24$ が異なる。図7(A)中、矢印T1方向に加わったときの変化を同図(B)に、矢印T2方向に加わったときの変化を同図(C)に、矢印T3方向に加わったときの変化を同図(D)に、矢印T4方向に加わったときの変化を同図(E)に各々示す。

## [0046]

ここで、例えばVz=Va-VcまたはVz=Vb-Vdであると矢印T1方向にFx, Fyの合力が作用したときにFzが反応しない。また、Vz=Va-VdまたはVz=Vb-VcであるとFzとして反応する。これらの関係を表 2に示す。

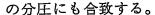
### [0047]

#### 【表2】

モーメント	Va-Vc	Va-Vd	Vb-Vc	VbNq
T1方向	0	+	_	0
T2方向		0	0	+
T3方向	_	0	0	+
T4方向	0	+	_	0

#### [0048]

そこで、Vz=(Va-Vc)+(Vb-Vd)とすることにより、矢印 $T1\sim T4$ 方向の力が作用しても打ち消しあってFzを正確に出力することができる。同様にVz=(Va-Vd)+(Vb-Vc)とすることもできる。なお、節点電圧 $Va\sim Vd$ が各モードにおいて変化するのは、歪みゲージの抵抗が大きくなる(+)のとき( $R+\triangle R$ )と歪みゲージの抵抗が小さくなる(-)のとき( $R-\triangle R$ )とすることにより、オームの法則



## [0049]

なお、本実施形態では力Fx(モーメントMy)、力Fy(モーメントMx)、力Fz について求めているが、これには限られず各軸方向への加速度や角加速度を求めるようにしてもよい。この場合、受力部 13 の先端に重量体を取り付けることにより受力部 13 の触れを大きくして感度を高めることができる。

#### [0050]

#### [0051]

#### [0052]

あるいは、図11に示すように、R11~R14からなるブリッジ回路11aとR21~R24からなるブリッジ回路11bとを並列に備えたブリッジ回路11としてもよい。ここでは図10に示すR21~R24からなるブリッジ回路11bでの歪みゲージR11~R24を入れ替えている。この場合、Fx(My)はR11~R14のブリッジ回路11aでVx=Va-Vbより、Fy(Mx)はR21~R24のブリッジ回路11bでVy=Vc-Vdより各々算出される。またFzについては、Vz=Va+Vb+Vc+Vd、またはVz=Va+Vb、またはVz=Vc+Vdにより算出される。

#### [0053]

一方、上述した固定されたブリッジ回路11には限られず、図12に示すような検出回路16を利用してもよい。この検出回路16では、環状に連結した歪みゲージR11~R24と、歪みゲージR11~R24に駆動用電圧V+とGNDを切り換えて設定するスイッチ17と、このスイッチ17を制御すると共に節点電圧を演算処理して力やモーメントを算出するマイコン18とを備えている。歪みゲージR11~R24の接続および節点電圧の設定は図4に示すブリッジ回路11と同様である。ここでは、R11とR14の節点e、R21とR24の節点fを設定している。

## [0054]

モーメントMx, Myを求める場合は、マイコン18の出力ポートの信号POをオフにしてスイッチ17の出力端子を図中1,3,5側に接続する。これにより、ブリッジ回路11の節点 e,f は駆動用電圧 V に接続され、節点 g,h は GNDに接続される。すなわち、歪みゲージR11~R14で構成されるブリッジ回路11aと、歪みゲージR21~R24で構成されるブリッジ回路11bとからなるブリッジ回路11が構成される。このときのブリッジ回路11を図13に示す。そして、モーメントMx(力Fy)は節点電圧 V c, V d の 差 V y として検出できる。また、モーメント M y (力 F x) は節点電圧 V a, V b の 差 V x として検出できる。

# [0055]

カFzを求める場合は、マイコン18の信号POをオンにしてスイッチ17の出力端子を図12中2,4,6側に接続する。これにより、ブリッジ回路11の節点bは駆動用電圧Vに接続され、節点cはGNDに接続される。節点g,hはGNDから切り離され、節点e,fは駆動用電圧V+から切り離される。検出回路16は8個の歪みゲージR11~R24からなる1個のブリッジ回路11となる。このときのブリッジ回路11を図14に示す。カFzは節点電圧Va,Vdの差Vzとして検出できる。

## [0056]

これらの電圧Vx, Vy, VzはOPアンプ19で演算されてマイコン18のAD変換ポートに入力される。マイコン18では出力ポートPOの状態(オンかオフ)に応じてモーメントMx, Myを検出する場合か力Fzを検出する場合かを判別して、不要なデータ、例えばモーメントMx, Myを検出する場合の力Fzのデータを無視するようにする。

#### [0057]

この動作の繰り返しによりモーメントMx, Myと力Fzとを時分割で精度良く検出することができる。

#### [0058]

次に、本発明の第2の実施の形態について、図15を参照して説明する。図15に示すように、第2の実施の形態は、歪みゲージR101~R204としてピエゾ抵抗素子を用いている。そして、半導体製造プロセスを利用して、1つの多軸センサユニット10に必要なピエゾ抵抗素子を1枚のシリコン半導体基板20に集積して起歪体12にダイボンディング(はんだ付け)して固定している。ピエゾ抵抗素子は箔歪みゲージに比べてゲージ率が10倍以上大きく、箔歪みゲージを利用する場合に比べて感度を10倍以上大きくすることができる。また、ICの半導体プロセスを利用して、検出素子であるピエゾ抵抗素子のみならず信号処理用のOPアンプなどの回路素子までも同じ半導体基板20に作製でき集積化できるようになる。

#### [0059]

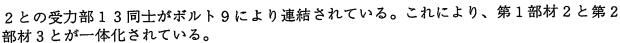
次に、本発明の第3の実施の形態について、図16を参照して説明する。図16に示すように、第3の実施の形態は、歪みゲージおよびブリッジ回路としてスパッタリングにより形成した酸化クロム膜21を使用している。すなわち、起歪体12にスパッタリングにより絶縁膜22を形成し、その上にスパッタリングにより酸化クロム膜21を形成し、その上に保護膜23を形成する。絶縁膜22は起歪体12と酸化クロム膜21とが導通しないようにするものである。酸化クロム膜21はスパッタリングにより形成し、歪みゲージと導電性のブリッジ回路とを同時に形成することができる。歪みゲージとなる部分は歪み検出の方向に線幅が細くなり抵抗値が大きくなるようにしている。保護膜23は酸化防止と物理的な接触による損傷防止のために設ける。

### [0060]

更に、本発明の第4の実施の形態について、図17~図18を参照して説明する。図17 (A)は、本発明の第4の実施の形態による多軸センサ1を第2部材3側からZ軸方向に透視したときの歪みゲージR11~R48の配置を描いた平面図であり、図17(B)は多軸センサ1の中央縦断面正面図である。図17において、多軸センサ1は、多軸センサユニット4~7を複数備えると共に、第1部材2と第2部材3とに外部から加わった多軸の力、モーメント、加速度、角加速度のいずれかを計測するものである。第1部材2および第2部材3は円盤形状のフランジから成る。歪みゲージR11~R48は第1部材2の表側面2aのみに取り付けられている。

#### [0061]

第1部材2は、4つの多軸センサユニット4,5,6,7を備えている。ここで、4つの多軸センサユニット4,5,6,7は、いずれも第1の実施の形態の多軸センサユニット10と同様の構成であって、上述と同様のブリッジ回路11または検出回路16がそれぞれに設けられている。第2部材3は、第1部材2の多軸センサユニット4~7に対向する4つの起歪体12を備えている。互いに向き合う多軸センサユニット4~7と起歪体1



# [0062]

多軸センサユニット  $4\sim7$  は多軸センサ1 の中心点O を中心に等角度おき、かつ中心点O から等距離に配置されている。ここでは、9 0 度おきに配置されている。さらに、多軸センサユニット  $4\sim7$  は、中心点O を原点とするX 軸およびY 軸上の正方向および負方向にそれぞれ配置されている。よって、この多軸センサ1 は3 次元空間の直交する3 軸の力とその軸回りのモーメントを測定するための6 軸力覚センサとして機能する。また、原点O から第1 部材2 側への垂直線をZ 軸としている。図1 8 に、X 軸、Y 軸、Z 軸の方向と、A 各軸に対するモーメントA X 、A Y 、A Z の方向を示す。

# [0063]

各多軸センサユニット4~7は大きさや厚さを同じにしている。このため、剛性が等しくなる。これにより、第1部材2と第2部材3と受力部13とが全体として平行四辺形の四辺を構成するように変位するときに、各多軸センサユニット4~7に力の方向や大きさに応じた歪みが歪みゲージR11~R48に発生するようになるので、力やモーメントを高精度に検出することができる。なお、歪みゲージの取り付け作業を簡易にしたり歪みゲージの保護を図るために、取り付け位置に段差を設けてもよい。また、ダイヤフラム部15以外の部分には他の部材への取り付け用のタップ穴を形成してもよい。

## [0064]

図19に、各歪みゲージR11~R24を接続してなるブリッジ回路11を示す。なお、ブリッジ回路11は、第1の実施の形態で説明したものはいずれも適用可能であるが、ここでは、その一例について説明する。図19に示すように、多軸センサユニット4については、R11~R14からなるブリッジ回路とR15~R18からなるブリッジ回路とを並列に備えたブリッジ回路11が設けられている。また、多軸センサユニット5~7については、R21~R24、R31~R34、R41~R44からなるブリッジ回路とR25~R28、R35~R38、R45~R48からなるブリッジ回路とをそれぞれ並列に備えたブリッジ回路11が設けられている。

#### [0065]

### [0066]

 $V \times 1 = V \times 1 - V \times 1$ 

V v 1 = V c 1 - V d 1

Vz 1 = Va 1 + Vb 1 - Vc 1 - Vd 1

## [0067]

#### [0068]

従って、本実施の形態では、各多軸センサユニット4~7で得られた結果を利用して、6軸の力およびモーメント成分は、次のような演算により求めることができる。ただし、各多軸センサユニット4~7の3軸分の信号出力のうちで使用しない信号もある。ここで、下記の演算では、各抵抗値を既知または新規の手段を用いて電圧に変換し、OPアンプで演算してもよく、あるいはAD変換器を用いてマイクロコントローラやコンピュータを

用いて計算してもよい。

# [0069]

Fx = Vx4 - Vx2

F v = V v 3 - V v 1

 $F_z = V_z 1 + V_z 2 + V_z 3 + V_z 4$ 

M x = V z 4 - V z 2

M y = V z 3 - V z 1

Mz = Vy1 + Vx2 + Vy3 + Vx4

# [0070]

なお、3次元空間の直交する3軸の力とその軸回りのモーメントを測定するための6軸力覚センサとして機能する多軸センサ1のブリッジ回路11を用いた演算方法については、本件出願人による特願2000-172045号公報に詳細に記載されている。

# [0071]

更に、本発明の第5の実施の形態について、図20を参照して説明する。図20は、第5の実施の形態による多軸センサ1を第2部材3側から2軸方向に透視したときの歪みゲージR11~R38の配置を描いた平面図である。第5の実施の形態では、第1部材2に3つの多軸センサユニット4~6を備えている。第2部材3は各多軸センサユニット4~6に対向する3つの起歪体12を備えている。多軸センサユニット4~6は多軸センサ1の中心点Oを中心に120度おき、かつ中心点Oから等距離に配置されている。

## [0072]

本実施の形態の3つの多軸センサユニット4,5,6は、いずれも第1の実施の形態の多軸センサユニット10と同様の構成であって、上述と同様のプリッジ回路11または検出回路16がそれぞれに設けられている。この場合も、各多軸センサユニット4~6で得られた結果を利用して、6軸の力およびモーメント成分を検出することができる。従って、本実施の形態の多軸センサ1は、上述の第4の実施の形態と同様に、3次元空間の直交する3軸の力とその軸回りのモーメントを測定するための6軸力覚センサとして機能する。なお、多軸センサ1のブリッジ回路11を用いた演算方法については、第4の実施の形態と同様であるので、詳細な説明は省略する。

### [0073]

次に、本発明の第6の実施の形態について説明する。上述した第4および第5の実施形態では第1部材2と第2部材3とを互いに取り付けているが、第1部材2のみを単独で使用してもよい。この場合、多軸センサユニット10の受力部13に作用体として重量体を取り付けることにより、多軸センサユニット10に作用する多軸の加速度および角加速度を計測することができる。

## [0074]

以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な設計変更が可能なものである。例えば、上述したプリッジ回路11では定電圧とGNDを加える駆動方式としているが、これには限られず正負の両電圧を加えて駆動するようにしてもよい。あるいは定電圧の代わりに定電流を加えて駆動するようにしてもよい。

## [0075]

また、上述した各実施形態での歪みゲージの配置は図示したものに限られないのは勿論である。歪みゲージの配置を変更しても、ブリッジ回路11の各節点電圧の差や和などの演算によってMx, My, Fzなどが求まればよい。

#### [0076]

そして、上述した実施形態では3軸または6軸の力やモーメントを検出するセンサとしているが、これには限られず例えばX軸とY軸の2方向の力やモーメントだけを検出する2軸センサとして使用してもよい。または、X軸、Y軸、Z軸のうちどれか1方向の力あるいはモーメントだけを検出する1軸センサとして使用してもよい。

# 【図面の簡単な説明】

[0077]

【図1】本発明の第1の実施の形態による多軸センサユニットを描いた図であり、(A) は歪みゲージの配置を描いた平面図、(B) は中央縦断面正面図である。

【図2】多軸センサに力Fxを加えたときの変位および歪みゲージの抵抗値の変化を示す中央縦断面正面図である。

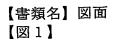
- 【図3】多軸センサに力Fzを加えたときの変位および歪みゲージの抵抗値の変化を示す中央縦断面正面図である。
- 【図4】ブリッジ回路の一例を示す回路図である。
- 【図5】 〇 P アンプを用いた節点電圧の演算処理の例を示す図である。
- 【図6】Fxを算出するためのブリッジ回路の一例を示す回路図であり、(A)は全体図、(B)は実質的な等価回路を示す。
- 【図7】 Fz を算出するための参照図であり、(A)は力の加わる方向、(B)は矢印T1 方向に加わったときのブリッジ回路、(C)は矢印T2 方向に加わったときのブリッジ回路、(D)は矢印T3 方向に加わったときのブリッジ回路、(E)は矢印T4 方向に加わったときのブリッジ回路をそれぞれ示す。
  - 【図8】ブリッジ回路の他の例を示す回路図である。
  - 【図9】ブリッジ回路の更に他の例を示す回路図である。
  - 【図10】ブリッジ回路の別の例を示す回路図である。
  - 【図11】ブリッジ回路の更に別の例を示す回路図である。
  - 【図12】検出回路の一例を示す図である。
- 【図13】検出回路によりMxまたはMyを求めるときに形成されるブリッジ回路を示す回路図である。
- 【図14】検出回路によりFzを求めるときに形成されるブリッジ回路を示す回路図 である。
- 【図15】第2の実施の形態による多軸センサユニットを描いた中央縦断面正面図である。
- 【図16】第3の実施の形態による多軸センサユニットを描いた一部省略の縦断面図である。
- 【図17】本発明の第4の実施の形態による多軸センサを描いた図であり、(A)は第2部材側から2軸方向に透視したときの歪みゲージの配置を描いた平面図、(B)は中央縦断面正面図である。
- 【図18】直交座標軸を示す斜視図である。
- 【図19】ブリッジ回路の一例を示す回路図である。
- 【図20】第5の実施の形態による多軸センサの第2部材側から Z軸方向に透視したときの歪みゲージの配置を描いた平面図である。
- 【図21】従来の多軸センサユニットを描いた中央縦断面正面図である。
- 【図22】従来の多軸センサユニットの歪みゲージの配置を描いた平面図である。
- 【図23】従来の多軸センサユニットの歪みゲージにより形成されるブリッジ回路を示す回路図である。

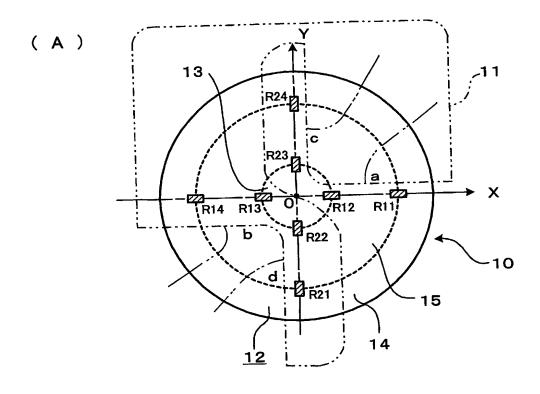
# 【符号の説明】

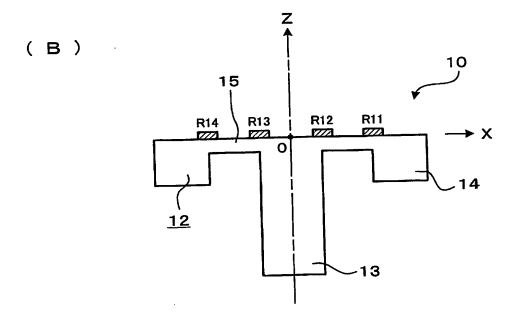
[0078]

- 1 多軸センサ
- 2 第1部材
- 3 第2部材
- 4~7 多軸センサユニット
- 10 多軸センサユニット
- 11 ブリッジ回路
- 12 起歪体
- 13 受力部
- 1 4 固定部

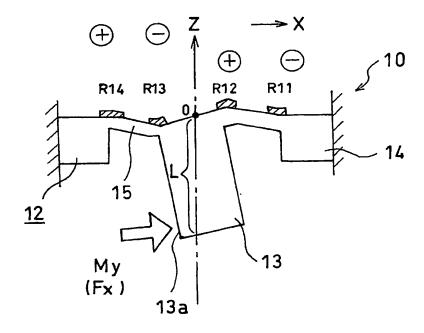
15 ダイヤフラム部 R11~R48 歪みゲージ



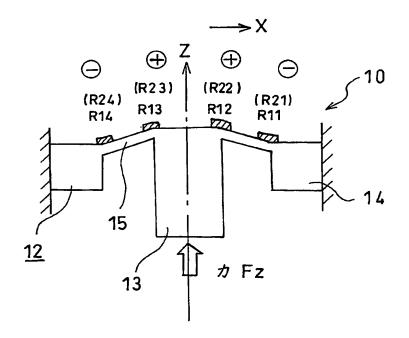




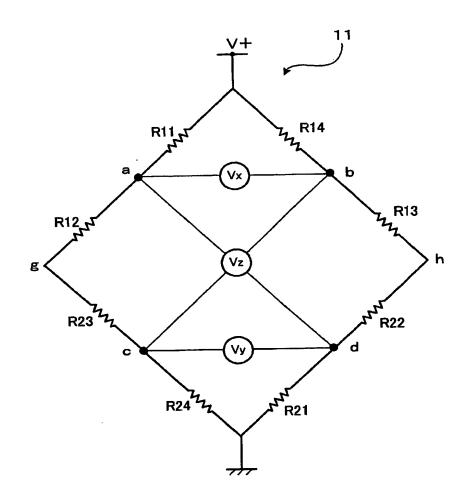
【図2】



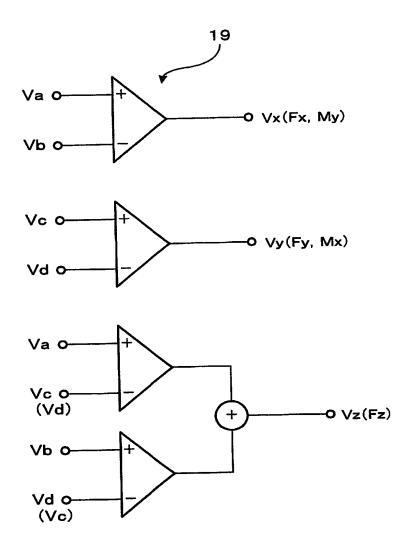
【図3】



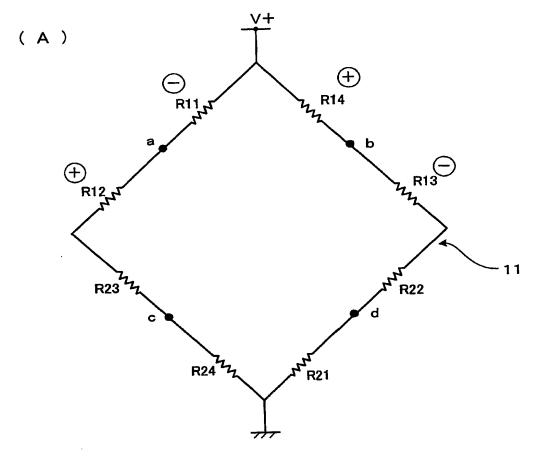


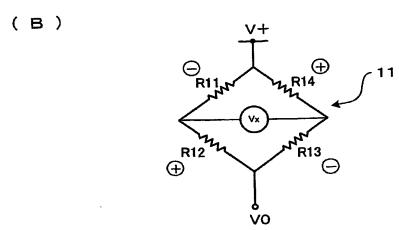




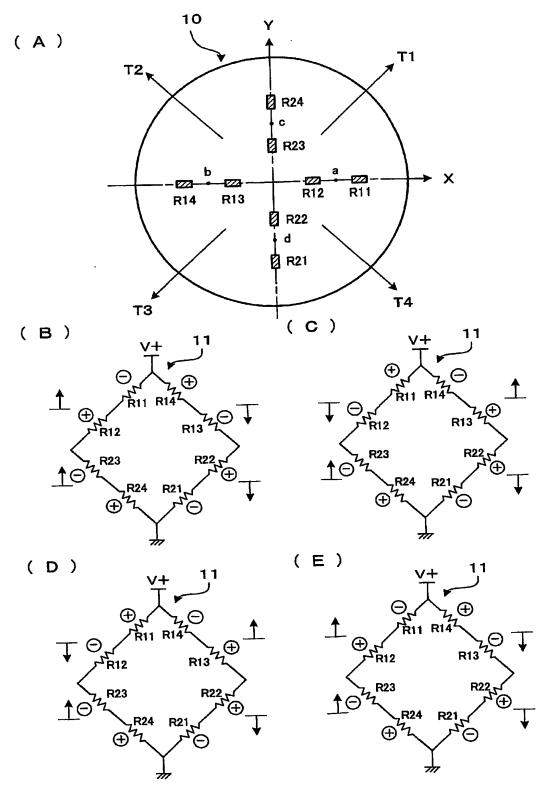




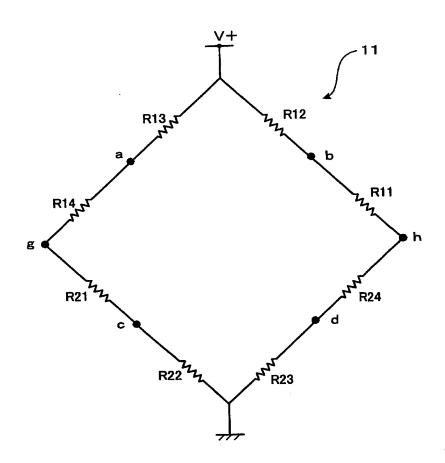




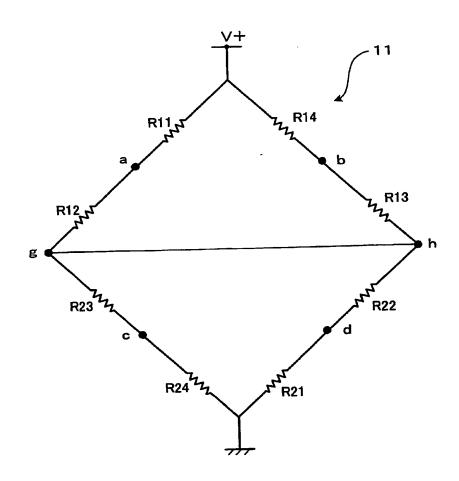
# 【図7】



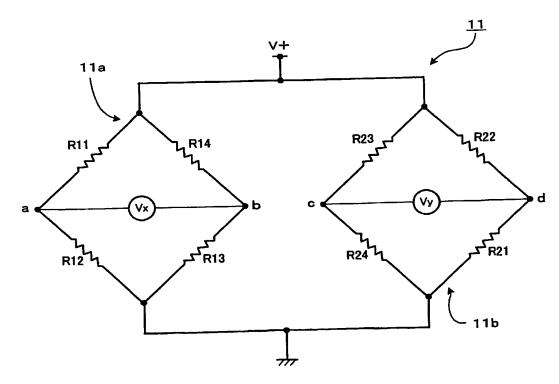




【図9】

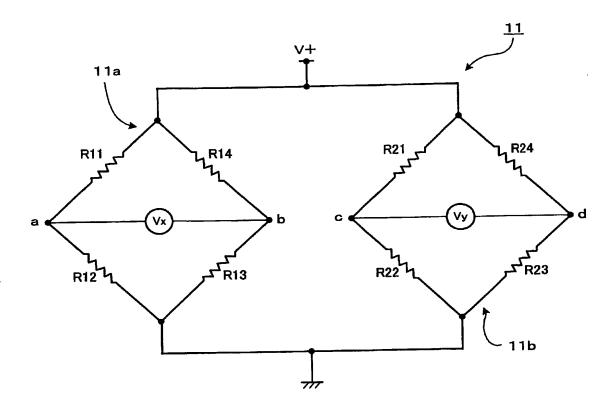


【図10】

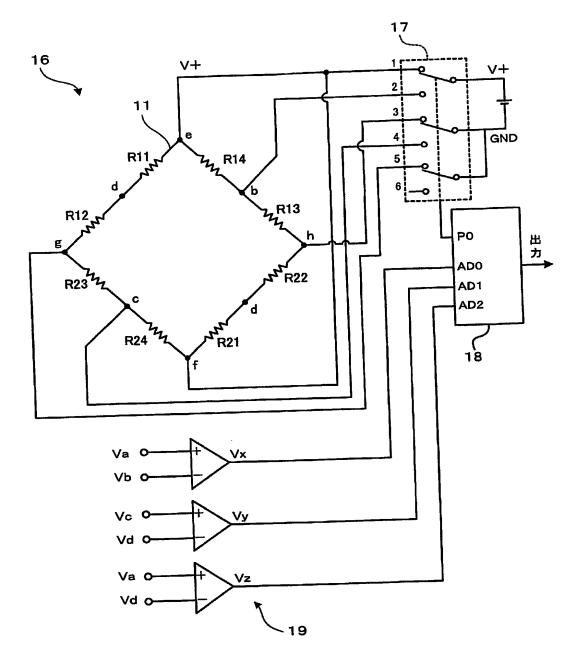


出証特2004-3074976

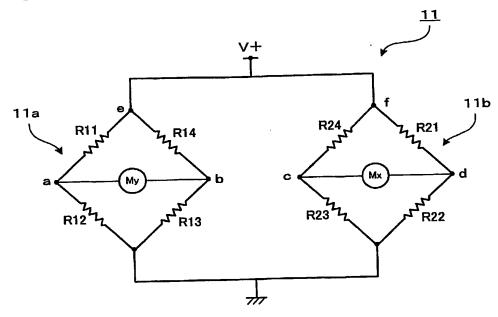




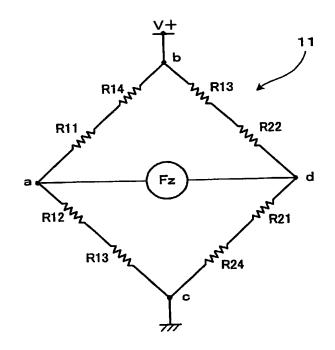




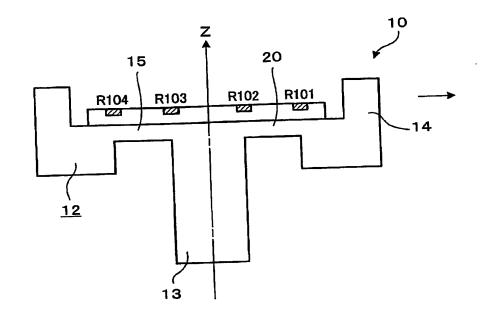
【図13】



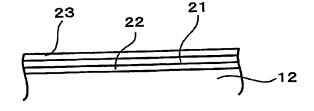
【図14】



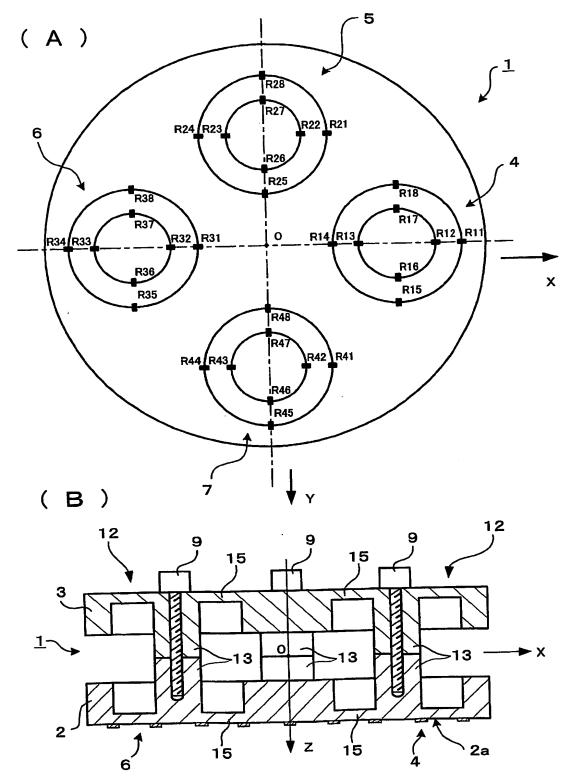
【図15】



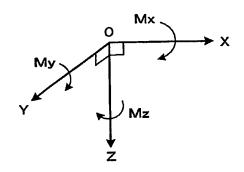
【図16】



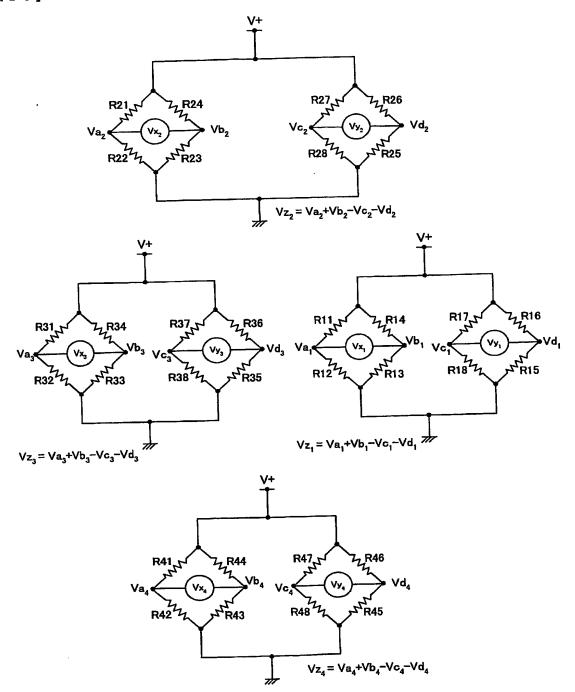




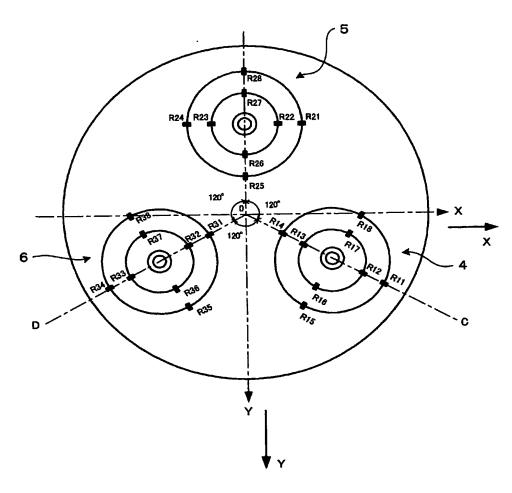
【図18】



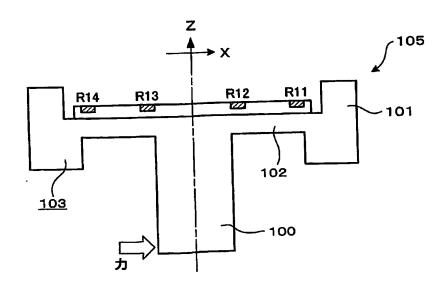
# 【図19】



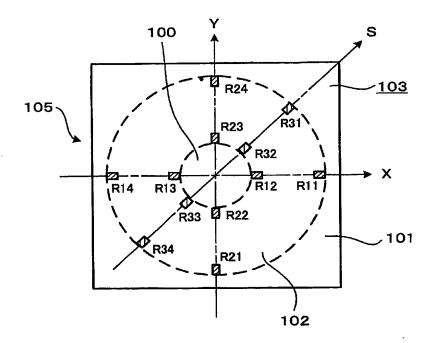




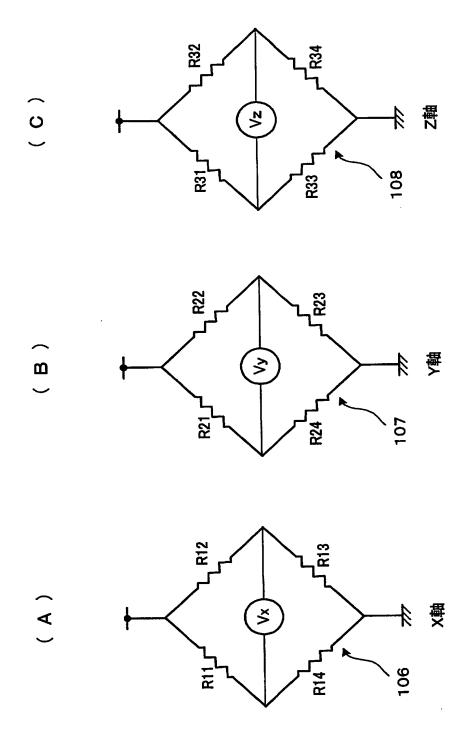
【図21】



# 【図22】









【要約】

【課題】 消費電力を低減すると共に配線を簡素にしコストを低減する。

【選択図】図1

特願2003-341451

出願人履歴情報

識別番号

[000111085]

1. 変更年月日

2002年 2月21日

[変更理由]

住所変更

住所

大阪府大阪市浪速区桜川4丁目4番26号

氏 名 ニッタ株式会社